

南亞科技股份有限公司 未來之星獎學金辦法

一、目的：

為培養半導體領域尖端人才並獎勵優秀學子專心致力於相關學術研究與創新技術，南亞科技股份有限公司(以下稱「本公司」)特設立本獎學金辦法，協助大專院校之有志青年積極追求理想與目標，勇敢迎向未來。

二、申請時間：

(1) **2021 年 10 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日**，以郵戳為憑，逾期不受理。

(2)申請作業：申請人需於期限內，按本辦法之第六條款所列之應繳文件，完整填具並依照檢核單所列順序編碼排序，一律上傳電子檔至本公司指定雲端位置。

聯絡資訊：南亞科獎學金專案小組 Futurestar@ntc.com.tw

備註：上傳雲端 QR Code 如左列



(3)獎學金發放：自取得獎學金資格起三個月內，本公司將一次性發放獎學金。所提供之帳戶應為申請人本人之帳戶，倘若給予他人帳戶，將喪失獲獎資格並不另行通知。

(4)本公司核定獲獎名單後，會依序通知獲獎人於指定時間領取，並辦理公開發表，逾期將視同放棄，不另行通知；獲獎名單公布至公司官網與 FB 粉絲團，獎學金受獎儀式將另行通知。

三、申請資格：需符合以下條件

(1)對象：大學三(含)年級以上學士班、碩士班、博士班在學一般生(不含進修部、在職專班、在職學分班)。

(2)獎學金名額：學士班四名、碩士班六名、博士班三名，共計十三名；本公司得視申請狀況增減獎學金名額。

(3)學校/科系：國立大專院校(含科技大學)、長庚大學、長庚科技大學、明志科技大學；電機、電子、光電、材料、物理、化學、化工、資訊工程等相關理工系所。

(4)成績：

1.學業成績：前一全學年度學業成績 80 分(含)以上且所有學科科目均須及格者。

2.操行成績：前一全學年度操性成績 75 分(含)以上且在校期間未受記過處分者。

(5)未受領本公司其他之獎學金者或不得重複參加同一活動。

四、優先入選條件：研究論文或專題題目為『智慧時代創新、半導體或記憶體之主題』相關領域者，將獲得優先入選資格。

五、申請檢附文件：一律上傳至雲端

- (1)申請表乙份，浮貼兩吋照片。
- (2)學生證、身分證正反面影本各乙份，浮貼於申請表上。
- (3)前一全學年度成績單正本乙份(成績單上必須註明學業、操行成績)。
- (4)自傳(至少 800 字，內容需包個人優/劣勢、未來自我規劃等)。
- (5)研究計畫(對半導體產業之創意發想或貢獻尤佳)。
- (6)其他各類優秀佐證影本(得獎紀錄、專題研究、期刊投稿、證照等)。
- (7)一年內英文多益 TOEIC 達 600 分以上成績證明文件(非必要)。

六、評核審查流程：

- (1)第一階段初審(書面)：書面審查。
- (2)第二階段複審(口試)：由南亞科技安排口試後核定，簡報說明 20 分鐘，評審委員提問答詢 10 分鐘，選拔出各組別「金質獎」、「銀質獎」、「銅質獎」，進入複審未獲選則頒發「入圍獎」。

七、評核標準：

項目	細項說明	細項權重
初審 書面審查 40%	研究/專題目的	20%
	創新力/創新發想	20%
	研究計畫撰寫質量	20%
	研究/實作成果	20%
	半導體應用價值	20%
複審 口試審查 60%	簡報呈現	20%
	表達能力	20%
	專業知識與實務經驗	20%
	半導體應用	20%
	未來潛力	20%

八、獎學金內容：

(1) 博士班：

- 「金質獎」每名獎學金九萬元整。
- 「銀質獎」每名獎學金七萬五仟元整。
- 「銅質獎」每名獎學金五萬元整。
- 「入圍獎」每名獎學金一萬元整。

(2) 碩士班：

- 「金質獎」每名獎學金五萬元整。
- 「銀質獎」每名獎學金三萬元整。
- 「銅質獎」每名獎學金二萬元整。
- 「入圍獎」每名獎學金五仟元整。

(3) 學士班：

- 「金質獎」每名獎學金二萬元整。
- 「銀質獎」每名獎學金一萬五仟元整。
- 「銅質獎」每名獎學金一萬元整。
- 「入圍獎」每名獎學金五仟元整。

九、其他：

- 1.本辦法若有未詳盡事宜，依個案狀況討論。
- 2.獲獎同學保證其繳交資料等著作物無侵害他人之權利，如有違反，應自負一切法律責任。
- 3.本獎學金屬其他所得，本公司於給付時無須代為扣繳；本公司將依所得稅法規定發給免扣繳憑單，以憑辦理申報個人綜合所得稅。



檢核單

南亞科技股份有限公司

『未來之星獎學金』申請資料

一、姓名：_____

二、學校：_____

三、系所：_____

四、學號：_____

五、年級：_____

六、預計畢業年月： 年 月

說明：請依照所列順序編碼排序，上傳至本公司指定雲端位置。

- (1)申請表乙份(請浮貼兩吋照片)。
- (2)學生證、身分證正反面影本各乙份，浮貼於申請表上。
- (3)前一全學年度成績單正本乙份(成績單上必須註明學業、操性成績)。
- (4)自傳(至少800字，內容需包個人優/劣勢、未來自我規劃等)。
- (5)研究計畫(對半導體產業之創意發想或貢獻尤佳)。
- (6)其他各類優秀佐證影本(得獎紀錄、專題研究、期刊投稿、證照等)。
- (7)一年內英文多益TOEIC達600分以上成績證明文件(非必要)。

學士組 碩士組 博士組

姓 名		性 別		照 片		
身分證字號				(請確實黏貼兩吋照片)		
出生年月日						
手機電話						
E-mail						
目前就讀學校/系所			學 號			
戶籍地址						
通訊地址						
家長聯絡人						
家長電話			關 係			
學 歷	學 位	學 校 名 稱	科 系	起	迄	畢/肄業
	博 士			年 月	年 月	
	碩 士			年 月	年 月	
	大 學			年 月	年 月	
是否有意願參加 實習計畫	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 學年 <input type="checkbox"/> 學期					<input type="checkbox"/> 否

一、以上所填寫資料均屬實。

二、本人已詳讀南亞科技獎學金辦法，願意遵守相關規定。

三、本人同意南亞科技查核與本獎學金申請之任何相關資料。

填寫人：_____ (本人親筆正楷中文簽名)

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日



- 一、南亞科技股份有限公司就同學所填具之上述資料(含繳交之資料)，僅供本公司於營運地區及營運期間內，執行各項管理相關作業使用。
- 二、同學就其提供之個人資料得依個人資料保護法向本公司請求查詢、製給複製本、補充更正、請求停止蒐集、處理、利用及刪除等權利。
- 三、如所提供之資料包含第三人之個人資料時，應確認該第三人已知悉本同意書所載之相關事項及權利，並擔保已取得第三人之同意授權本公司依據本同意書之蒐集目的及使用期限，使用第三人之個人資料。

本人已充分了解上述告知事項並均予同意。

立同意書人：_____ (本人親筆正楷中文簽名)